

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-13

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	高盛、招商证券、中信证券、中银证券、华夏久盈、光证资管、泰康资产、泉果基金、创金合信基金、九泰基金、国泰基金、富国基金、景林资产、淳厚基金等
时间	2023年7月20日
地点	电话会议；深南电路股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司各主营业务主要涉及的下游领域。</p> <p>公司拥有 PCB、电子装联、封装基板三项主营业务。公司 PCB 业务产品下游以通信设备为核心，重点布局数据中心、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域；电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，公司主要聚焦通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域；封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。</p> <p>Q2、请介绍公司目前整体订单情况。</p> <p>受通信、数据中心、消费电子等领域需求较弱、部分下游客户去库存等因素影响，当前市场整体需求较为平淡，PCB 及封装基板业务的部分项目需求较 2023 年一季度短期内略有恢复，下游市场需求变化情况有待继续观察。</p>

Q3、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。

公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品，在保持国内通信市场稳定份额的同时，持续深耕海外通信市场。目前国内通信市场需求保持平淡，海外通信市场受局部地区 5G 项目进展延缓影响，需求增长有所放缓。从中长期看，国内与海外市场仍存在较大的通信基础设施建设需求，通信市场整体具备发展前景。

Q4、请介绍公司有线侧通信 PCB 产品是否有应用于交换机设备。

公司有线侧通信 PCB 产品承载数据的交换、传输等功能，广泛应用于电信网络路由器、交换机等数通设备，主要下游客户为通信、企业网等设备制造商。

Q5、请介绍公司 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。

数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。2022 年，受益于服务器市场 Whitley 平台切换的推进，公司 Whitley 平台用 PCB 产品占比持续提升。目前，公司已配合客户完成新一代 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力，现已逐步进入中小批量供应阶段。2022 年第三季度以来，受 EGS 平台切换进展延期及下游市场需求下滑影响，公司 PCB 业务数据中心领域短期内承压，目前部分项目需求较 2023 年一季度略有恢复。

Q6、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。公司持续加大对汽车电子市场开发力度，南通三期工厂产能爬坡顺利推进，汽车电子领域营收规模一季度同比继续实现增长，但占 PCB 整体营收比重相对较小。目前，汽车电子领域订单相对保持平稳。

Q7、请介绍公司南通三期项目连线后产能爬坡进展。

公司南通三期工厂于 2021 年第四季度连线投产，2022 年底已实现单月盈利，目前产能爬坡进展顺利，产能利用率达到五成以上。

	<p>Q8、请介绍公司无锡基板二期工厂连线后产能爬坡进展。</p> <p>相较于常规 PCB 工厂，封装基板工厂需要构建起适应国际半导体产业链客户要求的生产、质量、经营等高效运营体系，产能爬坡周期较长。无锡基板二期工厂已于 2022 年 9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段，产线能力得到持续验证与提升，产能利用率达到两成以上。</p> <p>Q9、请介绍公司广州封装基板项目的建设进展。</p> <p>公司广州封装基板项目共分两期建设，其中项目一期部分厂房及配套设施主体结构已封顶，尚需完成相关附属配套工程建设。目前项目进展按计划顺利进行，预计将于 2023 年第四季度连线投产。</p> <p>Q10、请介绍公司目前 FC-BGA 封装基板研发进展。</p> <p>公司现已具备 FC-BGA 封装基板中阶产品样品制造能力，目前已有部分产品向客户进行送样验证。高阶产品技术研发按期顺利推进。</p> <p>Q11、请介绍公司在 AI 领域涉及的产品。</p> <p>公司部分 PCB 产品有应用于 AI 服务器领域，目前此类产品占比较低。</p> <p>Q12、请介绍公司是否涉及 HDI 方面业务。</p> <p>HDI 作为一种 PCB 制造工艺技术，可实现板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 7 月 21 日